

1 外形尺寸和部件组成 Shape & Dimensions and Parts &Components

- 外形尺寸：见图 1 和表 1
- 部件组成：见图 2 和表 2

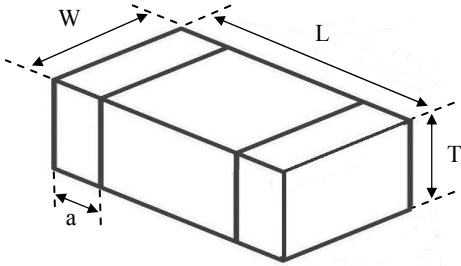


图 1 Fig.1

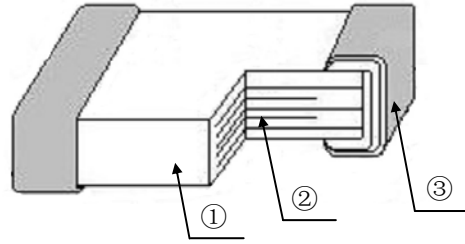


图 2 Fig.2

表 1 (Table 1)

类型 Type	L (mm)	W (mm)	T (mm)	a (mm)
0402	1.00±0.10	0.50±0.10	0.50±0.10	0.25±0.15
0603	1.60±0.15	0.80±0.15	0.80±0.15	0.30±0.20
0805	2.00±0.20	1.25±0.20	0.85±0.20	0.50±0.30

表 2 (Table 2)

部分 Part	①	②	③
组成 Component	片式压敏电阻用 ZnO 半导体陶瓷 ZnO Semiconductor Ceramics for Chip Varistor	内电极 (Ag 或 Ag-Pd) Internal Electrode (Ag or Ag-Pd)	端电极 (Ag/Ni/Sn 三层) Terminal Electrode (Ag/Ni/Sn three layers)

## 2 电气特性 Electrical Characteristics

型号 Part No.	最大工作电压 Max. Working Voltage	压敏电压 Varistor Voltage @1mA DC	最大限位电压 Max. Clamping Voltage	最大漏电流 Max. Leakage Current @V <sub>DC</sub>	电容 Capacitance @1MHz, 0.5V	ESD 接触放电 ESD Contact
	V <sub>DC</sub> (V)	V <sub>1mA</sub> (V)	V <sub>c</sub> (V)	IL(μA)	C <sub>p</sub> (pF)	KV
KESLP1608V05	15	100 ~ 160	200	5	0.5 ~ 1.5	≥8

## 3 检验和测试程序

### • 测试条件

如无特别规定，检验和测试的标准大气环境条件如下：

- 环境温度：20±15℃；
- 相对湿度：65±20%；
- 气压：86 kPa~106 kPa

如果对测试结果有异议，则在下述条件下测试：

- 环境温度：25±2℃；
- 相对湿度：65±5%RH；
- 气压：86kPa ~ 106kPa

### • 检查设备

外观检查：20 倍放大镜；

压敏电压测试：压敏电阻测试仪

## 3 Test and Measurement Procedures

### • Test Conditions

Unless otherwise specified, the standard atmospheric conditions for measurement/test as:

- Ambient Temperature: 20±15℃
- Relative Humidity: 65±20%
- Air Pressure: 86kPa to 106kPa

If any doubt on the results, measurements/tests should be made within the following limits:

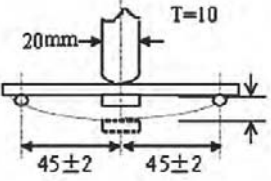
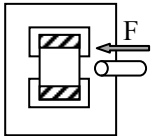
- Ambient Temperature: 25±2℃
- Relative Humidity: 65±5%
- Air Pressure: 86kPa to 106kPa

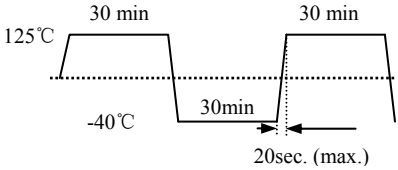
### • Inspection Equipment

Visual Examination: 20× magnifier

Varistor Voltage test: Varistor tester

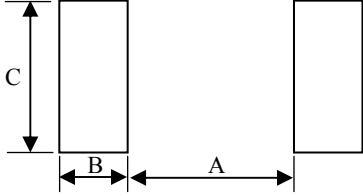
## 4 可靠性试验 Reliability Test

序号 No	项目 Items	测试条件/方法 Test conditions / Methods	要求 Requirements
1	抗弯强度 Bending Resistance	弯曲度 Warp: 2mm 速度 Speed<0.5mm/s 保持时间 Duration: 10s 	① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 试验前后压敏电压变化率≤5%。  ΔV <sub>1mA</sub> /V <sub>1mA</sub>   ≤5%
2	端头附着力 Terminal Strength	速度 Speed<0.5mm/s 作用力 Apply force: 5N 保持时间 Duration: 10±1s 	端电极无脱落。 No removal or split of the termination
3	可焊性 Solderability	焊接温度 Solder temperature: 240±5℃; 浸渍时间 Dipping Duration: 3±0.3s;	① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 元件端电极的焊锡覆盖率大于80%。 Wetting shall exceed 80% coverage.

4	耐焊性 Resistance to Soldering Heat	焊接温度 Solder temperature: 260±5℃; 浸渍时间 Dipping Duration: 5±1s;	
5	热冲击 Thermal Shock	高低温交替冲击 100 次。 High and low temperatures Transform for 100 Cycles. 	① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 试验前后压敏电压变化率≤10%。 $ \Delta V_{1mA}/V_{1mA}  \leq 10\%$
6	高温存放 High Temp. Storage	温度 Temperature: 125±2℃ 保持时间 Duration: 1000±24 h.	
7	低温存放 Low Temp. Storage	温度 Temperature: -40±2℃ 保持时间 Duration: 1000±24 h.	
8	高温负载 High Temp. Load	温度 Temperature: 85±2℃ 加载电压 Loading Voltage: $V_{DC}$ . 保持时间 Duration: 1000±24 h.	① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 试验前后压敏电压变化率≤10%。 $ \Delta V_{1mA}/V_{1mA}  \leq 10\%$
9	湿热负载 Damp Heat Load	温度 Temperature: 40±2℃ 湿度 Humidity: 90% ~ 95% RH. 加载电压 Loading Voltage: $V_{DC}$ . 保持时间 Duration: 500±12 h.	
10	最大浪涌电流 Maximum Surge Current	脉冲波形 Pulse waveform: 8/20 us 冲击次数: 正负极各一次 Number of hit: each 1 time of +/- polarity 加载电流: 最大浪涌电流 Applied current: maximum surge current ( $I_p$ )	① 无可见机械损伤; No visible mechanical damage. ② 试验前后压敏电压变化率≤10%。 $ \Delta V_{1mA}/V_{1mA}  \leq 10\%$

5 焊接建议 Soldering Recommendation

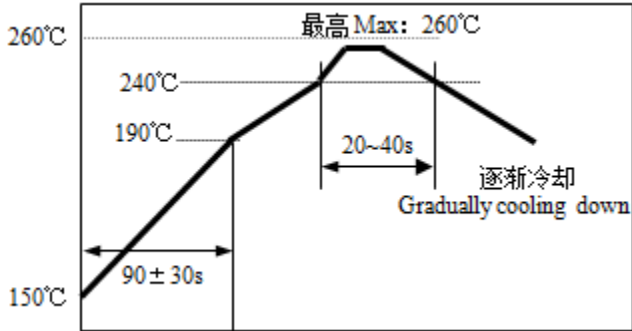
(1) 建议基板 Recommended Land pattern



类型 Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0603	0.60~0.80	0.60~0.80	0.60~0.80

(2) 建议焊接曲线 Recommended Soldering Profile

- 无铅锡膏: Sn/Ag/Cu (96.5/3.0/0.5)
- 最高温度时最长焊接时间: 10s
- 允许回流焊次数: 最多 2 次
- Pb Free Solder Paste: Sn/Ag/Cu (96.5/3.0/0.5).
- Max time at max temp: 10sec.
- Allowed Reflow time: 2x Max



6 储存条件 Storage

- 储存
  1. 初始包装贮存温度: -10°C ~ +40°C。
  2. 相对湿度: ≤70%RH。
  3. 远离腐蚀性气体和阳光。
  4. 储存期: 12 个月。
- Storage
  1. Storage temperature in original packaging: -10~+40°C.
  2. Relative Humidity: ≤70%RH.
  3. Keep away from corrosive atmosphere and sunlight.
  4. Period of Storage: 12 Months.